

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

电力公用事业

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片。



认证



功能

适用于采用 BGA 插座的 Intel、AMD、Via、Freescall、NVidia 和 Texas Instrument 处理器

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

适用于小尺寸电子设备的传导冷却解决方案（正在申请专利）

用导热胶带固定在 PCB 上

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片

兼容 Interscale C 型机箱

技术参数

Table 1/1					
物料号	类型	搭配使用	包装数量	深度	宽度
24830-005	热导体	仪器箱	1	22 mm	22 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE